

DA 90L 非导电胶 产品技术数据表

卓越的热循环性能

优异的机械冲击性能

高良率

简介

DA 90L 为一种以二氧化硅填充的、高触变性、无溶剂、快速固化的热固型非导电胶黏剂。该材料对基板及裸芯片具有优异的粘接性能, 适用于小尺寸及大尺寸芯片贴装应用。DA 90L 可通过点胶或印刷方式施工, 已验证其在高温回流条件下具有优异的可靠性表现。该产品专为高产能制造环境设计, 重点关注制程速度与机械冲击可靠性。材料易于点胶, 可有效降低内应力, 并提供卓越的可靠性表现(如温度循环性能)及优良的机械强度。与传统焊膏工艺相比, 其跌落测试性能提升可达两个数量级。

物理特性

产品名称	DA 90L 胶黏剂
未固化材料性能	
项目	数值
外观	白色
比重 (ASTM D1475-60)	21.8 g/cc
粘度 (ASTM D-1384)	10–50 kcp
固化后材料性能	
玻璃化转变温度 Tg (TMA, ASTM D3418-82)	149 °C
C.T. E (ASTM E 831), PPM /°C	$\alpha_1 = 35 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$ $\alpha_2 = 142 \text{ ppm/}^\circ\text{C}$
搭接剪切强度 (FR4/FR4)	2600 psi

提取离子(MIL-STD-883E)	
Na+	<5ppm
K+	<5ppm
F-	<5ppm
Cl-	<10ppm
表面绝缘电阻(J-STD-004)	通过

应用工艺

产线在线固化, 或88 – 110 °C × 30 – 90 分钟

注: 固化时间不包含胶层达到目标固化温度所需的升温时间。可根据实际工艺需求评估替代固化曲线。

储存与保质期

在 –40 °C 条件下、原厂密封容器中保存, 保质期为 6 个月。超过建议储存期限可能导致粘度上升。请避免受潮、挥发及外来杂质污染, 否则可能影响产品的加工性能。

安全说明

DA 90L 为环保型、无毒材料。但在操作过程中仍建议遵循一般工业卫生规范。详细安全信息请参阅本产品的 安全数据表。

包装规格

DA 90L系列非導電黏合劑提供10cc, 30cc 種規格。其他包裝規格可依客戶需求提供。如需訂購信息, 請聯繫YINCAE公司。